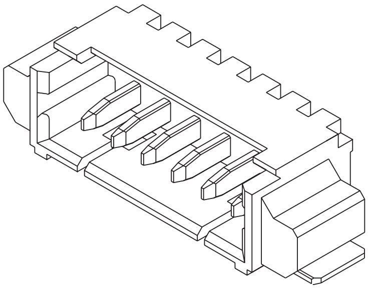
Jameco Part Number 1932580

1.25mm (.049") Pitch PicoBlade™ Wire-to-Board Header

53261

Right Angle, SMT



Features and Benefits

- Sizes 2 to 15 circuits
- Locking windows provide secure mating
- Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails

Reference Information

Packaging: Embossed tape
UL File No.: E29179
CSA File No.: LR19980
Mates With: 51021
Designed In: Millimeters

Electrical

Voltage: 125V
Current: 1.0A (32 AWG—0.8A)
Contact Resistance: 20 milliohms max.
Dielectric Withstanding Voltage: 250V AC/1 min.
Insulation Resistance: 100 Megohms min.

Physical

Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0
Contact: Phosphor Bronze
Plating: Tin
Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin plating
Operating Temperature: -40 to +85°C

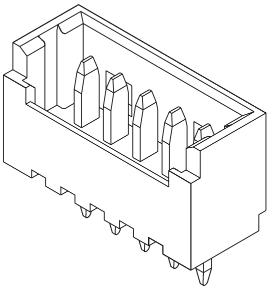
Circuits	Order No.	Carrier Tape Width	Lead-free
2	53261-0271	16.00 (.630)	Yes
3	53261-0371		
4	53261-0471	24.00 (.945)	
5	53261-0571		
6	53261-0671		
7	53261-0771		
8	53261-0871		
9	53261-0971		
10	53261-1071		

Circuits	Order No.	Carrier Tape Width	Lead-free
11	53261-1171	32.00 (1.260)	Yes
12	53261-1271		
14	53261-1471	44.00 (1.732)	
15	53261-1571		

1.25mm (.049") Pitch PicoBlade™ Wire-to-Board Header

53047

Vertical



Features and Benefits

- Sizes 2 to 15 circuits
- Locking windows provide secure mating

Reference Information

Packaging: Tray
Mates With: 51021
Designed In: Millimeters

Electrical

Voltage: 125V
Current: 1.0A (32 AWG—0.8A)
Contact Resistance: 20 milliohms max.
Dielectric Withstanding Voltage: 250V AC/1 min.
Insulation Resistance: 100 Megohms min.

Physical

Housing: 6/6 nylon, UL 94V-0
Contact: Phosphor Bronze
Plating: Tin
Operating Temperature: -40 to +85°C

Circuits	Order No.	Lead-free
2	53047-0210	Yes
3	53047-0310	
4	53047-0410	
5	53047-0510	
6	53047-0610	
7	53047-0710	
8	53047-0810	

Circuits	Order No.	Lead-free
9	53047-0910	Yes
10	53047-1010	
11	53047-1110	
12	53047-1210	
13	53047-1310	
14	53047-1410	
15	53047-1510	

molex	**PRODUCT SPECIFICATION**	LANGUAGE
		JAPANESE ENGLISH

[1. 適用範囲　SCOPE]

本仕様書は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

殿 に納入する

1.25mmピッチ　SMT基板用　コネクタ　について規定する。

This specification covers the 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR series.

[2. 製品名称及び型番　PRODUCT NAME AND PART NUMBER]

製品名称 Product Name		製品型番 Part Number
ターミナル　Male Terminal （AWG #26-28）	無　鉛 LEAD FREE	50079-8*00
ターミナル　Male Terminal （AWG #28-32）	無　鉛 LEAD FREE	50058-8*00
ハウジング　Housing	無　鉛 LEAD FREE	51021-**00
ウェハー　アッセンブリ Wafer Assembly　(R/A)	無　鉛 LEAD FREE	53261-**19
ウェハー　アッセンブリ Wafer Assembly　(R/A)	無　鉛 LEAD FREE	53261-**71 (エンボステープ入り　Embossed　Tape Package)
ウェハー　アッセンブリ Wafer Assembly　(ST.)	無　鉛 LEAD FREE	53398-**19
ウェハー　アッセンブリ Wafer Assembly　(ST.)	無　鉛 LEAD FREE	53398-**71 (エンボステープ入り　Embossed　Tape Package)

*：図面参照　Refer to the drawing.

[3. 定格及び適用電線　RATINGS AND APPLICABLE WIRES]

項目 Item	規格 Standard		
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	125 V（実効値 rms）		[AC(実効値　rms) / DC] 被覆外径：0.5～1.04mm MAX. Insulation　O.D
最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable wires	AWG. #26	1.0 A	
	AWG. #28	1.0 A	
	AWG. #30	1.0 A	
	AWG. #32	0.8 A	
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	-40℃　~　+85℃^{*1}		

REV.	A	B	C	D	E										
SHEET	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9										

REVISE ON PC ONLY		TITLE:
E	変　更 REVISED J2005-1671 ’04/12/06 E.SUZUKI	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR -LEAD FREE-　製品仕様書
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DESIGN CONTROL	STATUS	WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: YR/MO/DAY
J		E.SUZUKI	K.TOJO	M.SASAO	2004/02/05

DOCUMENT NUMBER		FILE NAME	SHEET
PS-51021-024		PS51021024.DOC	1 OF 9

EN-37-1(019)

*1: 通電による温度上昇分も含む。
Including terminal temperature rise.

[4. 性能　PERFORMANCE]

4-1. 電気的性能　ELECTRICAL PERFORMANCE

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧20mV 以下、短絡電流　10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	20 milliohm MAX.
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302B) Apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302B)	100 Megohm MIN.
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC250V （実効値）を１分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 250V AC(rms) between adjacent terminals or terminal and ground for 1 minute. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV 以下、短絡電流 10mA以下 にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, and measure contact resistance by dry circuit, 20mV MAX., 10mA.MAX.	5 milliohm MAX.

4-2. 機械的性能　MECHANICAL PERFORMANCE

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-2-1	挿入力 及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分 25±3mm の速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute.	第 7 参照 Refer to paragraph 7	
4-2-2	圧着部 引張り強度 Crimping Strength	圧着されたターミナルを治具に固定し、電線を軸方向に毎分25±3mm の速さで引張る。 (JIS C5402 6.8) Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3mm/minute. (JIS C5402 6.8)	AWG. #26	9.8 N｛1.0kgf｝MIN.
			AWG. #28	9.8 N｛1.0kgf｝MIN.
			AWG. #30	4.9 N｛0.5kgf｝MIN.
			AWG. #32	3.0 N｛0.3kgf｝MIN.
4-2-3	ターミナル 挿入力 Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿入する。 Insert the crimped terminal into the housing.	4.9 N｛0.5kgf｝MAX.	
4-2-4	ターミナル 保持力 Terminal/ Housing Retention Force	圧着されたターミナルをハウジングに装着し、電線を軸方向に毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force to the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25±3mm/minute.	4.9 N｛0.5kgf｝MIN.	
4-2-5	ピン保持力 Pin Retention Force	毎分　25±3mm　の速さで　ピンを軸方向に押す。 Apply axial push force at the speed rate of 25±3mm/minute.	4.9 N｛0.5kgf｝MIN.	

4-3. その他　OTHERS

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間に10回以下の速さで挿入、抜去を30回繰り返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30℃ MAX.
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な３方向に掃引割合10～55～10Hz/分 全振幅　1.5mmの振動を各２時間加える。 (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude : 1.5mm P-P Sweep ｔｉｍｅ : 10-55-10 Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each x.y.z. axes (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202 Method 201)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬　断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-4	耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に490m/s^2 {50G}，の衝撃を各３回加える。 （JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法213） 490m/s^2 {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C60068-2-27 MIL-STD-202　Method 213)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬　断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2℃の雰囲気中に96時間放置後取出し、1～2時間室温に放置する。 （JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法108） 85±2℃，96 hours (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3℃の雰囲気中に96時間放置後取出し、１～2時間室温に放置する。 （JIS C60068-2-1） -40±3℃，96 hours (JIS C60068-2-1)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2℃、相対温度90～95%の雰囲気中に96時間放置後取出し、１～2時間室温に放置する。 （JIS C60068-2-3/MIL-STD-202試験法103） Temperature : 60±2℃ Relative Humidity : 90～95% Duration : 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項を満たすこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	10 Megohm MIN.
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55℃に30分、+105℃に30分　これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は5分以内とする。試験後、1～2時間室温に放置する。 (JIS C0025) 5 cycles of : a) – 55℃ 30minute b) +105℃ 30minute (JIS C0025)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2℃ にて 5±1%重量比の塩水を48±4時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-3-10	耐亜硫酸ガス SO_2 Gas	コネクタを嵌合させ、40±2℃ にて 50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 24 hours expose to 50±5ppm . SO_2 gas at 40±2℃.	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-11	耐アンモニア性 NH_3 Gas	コネクタを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水を入れた容器中に40分間放置する。 （1Lに対して25mLの割合） 40 minutes exposure to NH_3 gas evaporating from 28% Ammonia solution.	外　観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より0.5mm迄、及び金具先端を245±3℃の半田に3±0.5秒浸す。 Soldering Time : 3±0.5 sec. Solder Temperature : 245±3℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes
4-3-13	半田耐熱性 Resistance To Solder-Ing Heat	(リフロー時) 第8項の条件を2回繰り返す。 When reflowing Repeat paragraph 8, condition two times.	端子ガタ、割れ等異状なきこと No Damage	
		(手半田) 端子先端より0.5mm迄、及び金具先端を、370～400℃の半田ゴテにて、 最大5秒加熱する。 Soldering iron method Soldering time : 5 sec. MAX. Solder temperature : 370～400℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip		

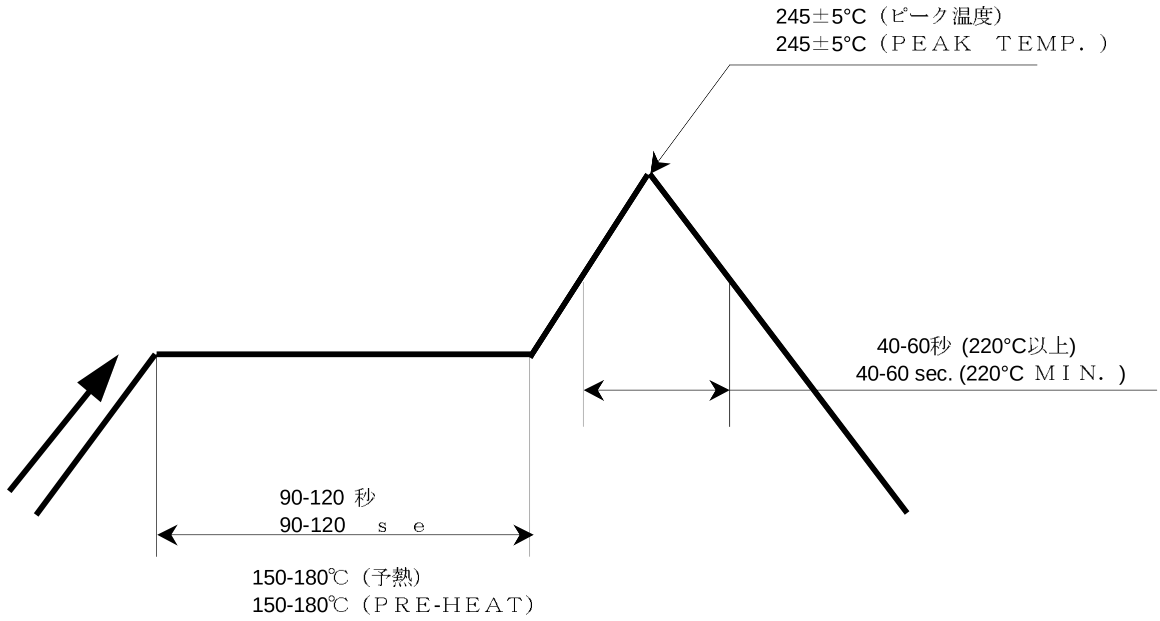
(　　　) : 参考規格　Reference Standard

{　　　} : 参考単位　Reference Unit

[5. 外観形状、寸法及び材質　PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS]

図面参照　Refer to the drawing.

[6.赤外線リフロー条件　INFRARED REFLOW CONDITION]



温度条件グラフ
(温度は基板パターン面)
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記；本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、
事前にリフロー評価の確認をお願い致します。
また吸湿などの前処理は行わないで下さい。

NOTE ; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand.
Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.
No moisture treatment before reflow process.

[7. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE]

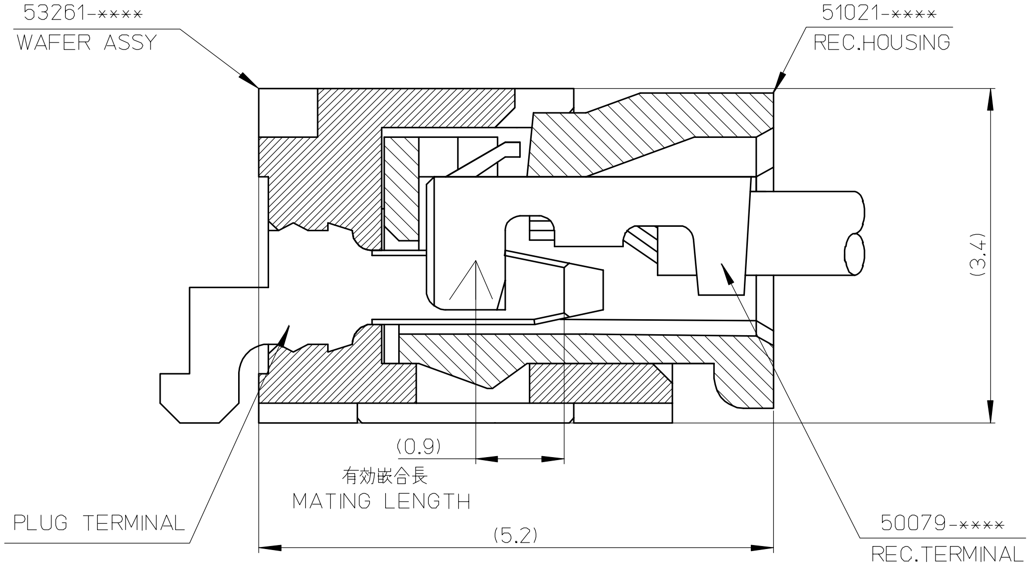
極数 No. of CKT.	単位 Unit	挿入力（最大値） Insertion force (MAX.)			抜去力（最小値） Withdrawal force (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
2	N { kgf }	19.6 { 2.0 }	17.6 { 1.8 }	15.6 { 1.6 }	2.8 { 0.28 }	2.3 { 0.23 }	1.8 { 0.18 }
3	N { kgf }	24.5 { 2.5 }	22.5 { 2.3 }	20.5 { 2.1 }	3.0 { 0.30 }	2.5 { 0.25 }	2.0 { 0.20 }
4	N { kgf }	29.4 { 3.0 }	27.4 { 2.8 }	25.4 { 2.6 }	3.3 { 0.33 }	2.8 { 0.28 }	2.3 { 0.23 }
5	N { kgf }	34.3 { 3.5 }	32.3 { 3.3 }	30.3 { 3.1 }	3.8 { 0.38 }	3.3 { 0.33 }	2.8 { 0.28 }
6	N { kgf }	39.2 { 4.0}	37.2 { 3.8 }	35.2 { 3.6 }	4.3 { 0.43 }	3.8 { 0.38 }	3.3 { 0.33 }
7	N { kgf }	44.1 { 4.5}	42.1 { 4.3 }	40.1 { 4.1 }	4.7 { 0.48 }	4.3 { 0.43 }	3.8 { 0.38 }
8	N { kgf }	49.0 { 5.0 }	47.0 { 4.8 }	45.0 { 4.6 }	5.2 { 0.53 }	4.7 { 0.48 }	4.3 { 0.43 }
9	N { kgf }	53.9 { 5.5 }	51.9 { 5.3 }	49.9 { 5.1 }	5.5 { 0.56 }	5.0 { 0.51 }	4.5 { 0.46 }
10	N { kgf }	58.8 { 6.0 }	56.8 { 5.8 }	54.8 { 5.6 }	5.8 { 0.59 }	5.3 { 0.54 }	4.8 { 0.49 }
11	N { kgf }	63.7 { 6.5 }	61.7 { 6.3 }	59.7 { 6.1}	6.1 { 0.62 }	5.6 { 0.57 }	5.1 { 0.52 }
12	N { kgf }	68.6 { 7.0 }	66.6 { 6.8 }	64.6 { 6.6}	6.4 { 0.65 }	5.9 { 0.60 }	5.4 { 0.55 }
13	N { kgf }	73.5 { 7.5 }	71.5 { 7.3 }	69.5 { 7.1 }	6.7 { 0.68 }	6.2 { 0.63 }	5.7 { 0.58 }
14	N { kgf }	78.4 { 8.0 }	76.4 { 7.8 }	74.4 { 7.6 }	7.0 { 0.71 }	6.5 { 0.66 }	6.0 { 0.61 }
15	N { kgf }	83.3 { 8.5 }	81.3 { 8.3 }	79.3 { 8.1 }	7.3 { 0.74 }	6.8 { 0.69 }	6.3 { 0.64 }

molex	**PRODUCT SPECIFICATION**	molex	LANGUAGE JAPANESE ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRTTN:	CH'K:
A	RELEASED	'04/02/05	J2004-2276	E.SUZUKI	K.TOJO
B	REVISED	'04/03/10	J2004-3002	E.SUZUKI	K.TOJO
C	REVISED	'04/03/29	J2004-3401	E.SUZUKI	K.TOJO
D	REVISED	'04/07/21	J2005-0243	N.AIDA	K.TOJO
E	REVISED	'04/12/06	J2005-1671	E.SUZUKI	K.TOJO

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書
E	SEE SHEET 1 OF 9	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
REV.	DESCRIPTION	

DOCUMENT NUMBER **PS-51021-024**	FILE NAME PS51021024.DOC	SHEET 10 OF 9



53261-****	WAFER ASSY		MODEL NO./MATERIAL NO.
50079-****	TERMINAL	REC.	
51021-****	HOUSING		

RELEASED
EC NO: J2006-2426
DRWN:YAOYAGI 2006/02/02
CH'KD:YMAEDA 2006/02/03
APPR:NUKITA 2006/02/07
DESCRIPTION
0
REV

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	± ---
10 OVER 30 UNDER	± ---
30 OVER	± ---
ANGULAR	± --- °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	
MM ONLY	---	METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY	DATE	
Y.AOYAGI	2006/01/30	
CHECKED BY	DATE	
Y.MAEDA	2006/01/30	
APPROVED BY	DATE	
N.UKITA	2006/01/30	

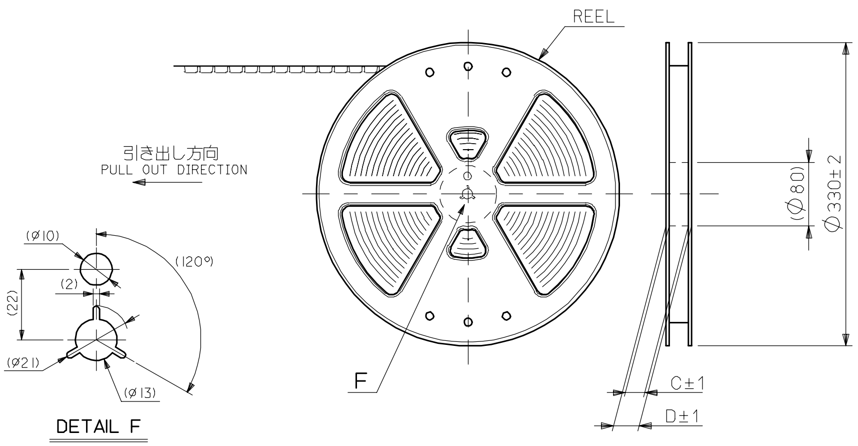
TITLE
1.25 W-TO-B CONN.
51021,53261
MATING CROSS SECTION

molex MOLEX INCORPORATED

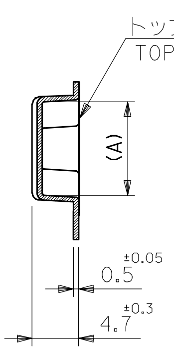
MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
SEE CHART	SD-51021-002	1 OF 1

SIZE A3

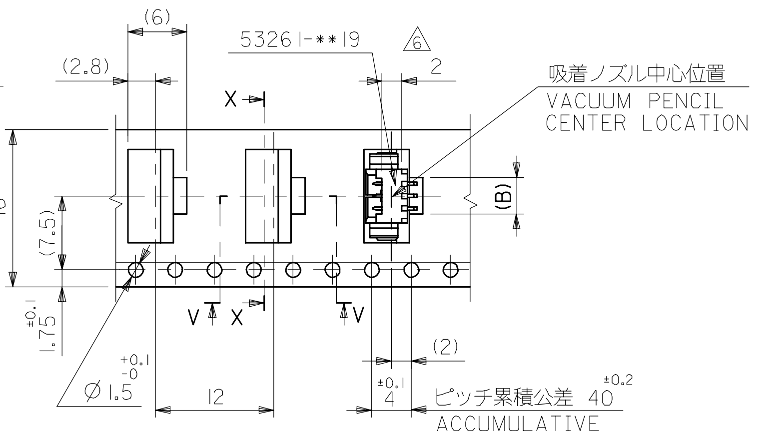
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



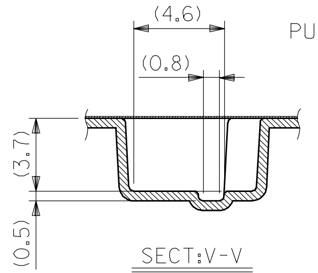
DETAIL F



SECT:X-X



引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

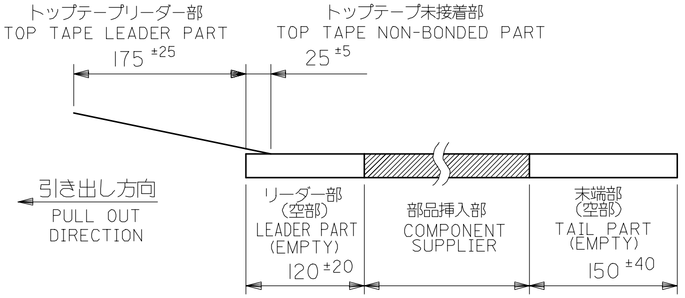


SECT:V-V

１６mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

注記
NOTES

1. 53261-**19 の詳細寸法については図面 SD-53261-024 を参照下さい。
   RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-53261-024
2. 梱包数量：１０００個／リール
   NUMBER OF CONNECTOR:1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



4. 材料 (MATERIAL)
   キャリアテープ(CARRIER TAPE):ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
   トップテープ (TOP TAPE): PET ,PE ,PEF
   リール (REEL):ポリスチレン（ＰＳ）<リサイクル材含む>
   POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

5. コネクタ、ハウジング平面部
   CONNECTOR, HOUSING FLAT AREA

6. 本製品は ５３２６１−＊＊９０ の鉛フリー品である。
   THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53261-**90

7. ELV及びRoHS適合品
   ELV AND RoHS COMPLIANT

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	B	A	MATERIAL. NO.	極数 CKT.
16	21.4	17.4	3.7	9.5	53261-0371	3
			2.45	8.25	53261-0271	2

MODEL NO.	53261-**71

REV	DESCRIPTION
B	REVISED EC NO: J2008-0056 DRWN:KSAIT001 2007/07/31 CH'KD:THARUYAMA 2007/07/31 APPR:NUKITA 2007/08/10

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3 °	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

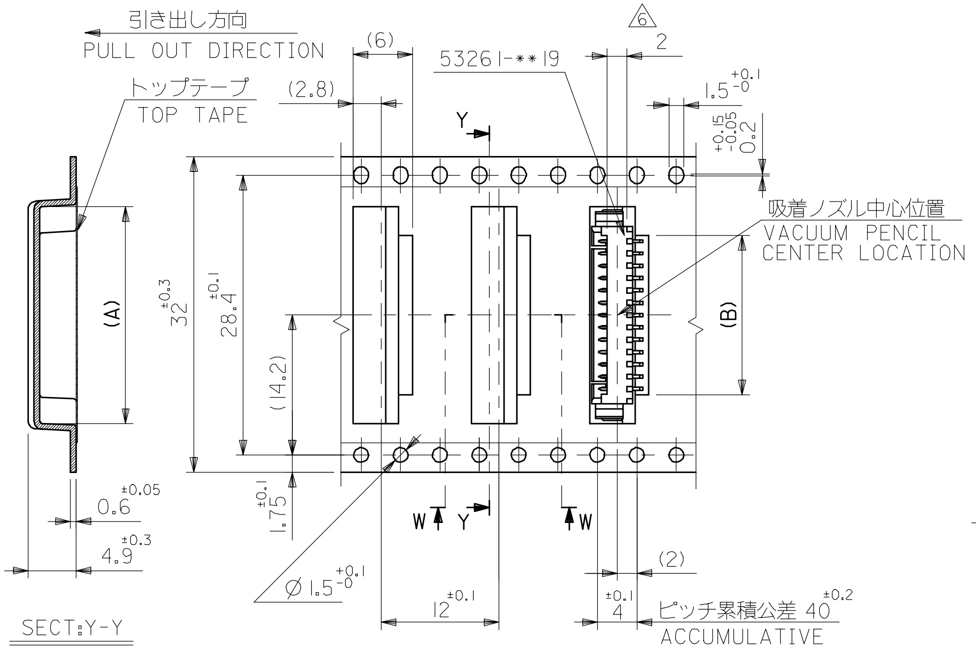
DIMENSION STYLE: MM ONLY	SCALE: ---	DESIGN UNITS: METRIC
DRAWN BY: H.SHIMABUKUR	DATE: '04/02/06	
CHECKED BY: K.TOJO	DATE: '04/02/06	
APPROVED BY: M.SASAO	DATE: '04/02/06	
MATERIAL NO.: SEE CHART	DOCUMENT NO.: SD-53261-023	SHEET NO.: 1 OF 3

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE
1.25 W/B CONN WAFER ASSY FOR SMT EMBSTP PKG

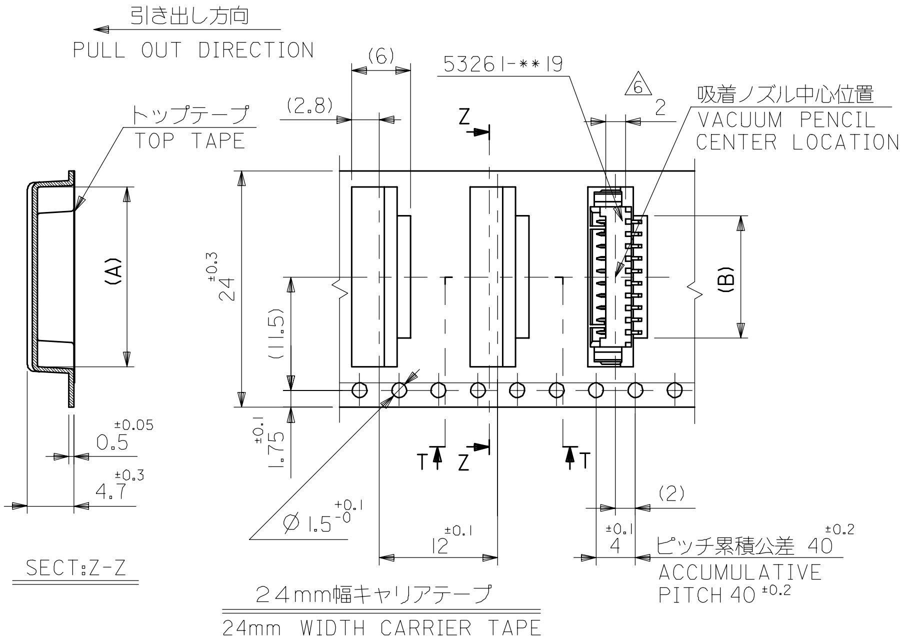
MOLEX INCORPORATED

SIZE A3



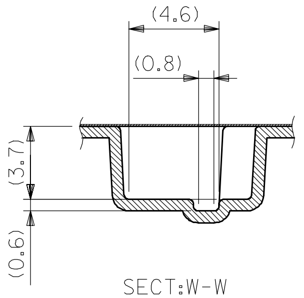
32mm幅キャリアテープ

32mm WIDTH CARRIER TAPE

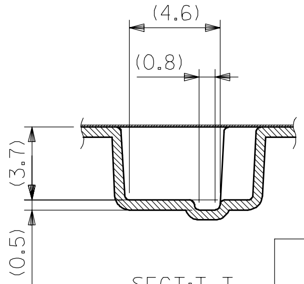


24mm幅キャリアテープ

24mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT:W-W



SECT:T-T

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	B	A	MATERIAL. NO.	極数 CKT.
32	37.4	33.4	16.2	22	53261-1371	13
			14.95	20.75	-1271	12
			13.7	19.5	-1171	11
24	29.4	25.4	12.45	18.25	-1071	10
			11.2	17	-0971	9
			9.95	15.75	-0871	8
			8.7	14.5	-0771	7
			7.45	13.25	-0671	6
			6.2	12	-0571	5
			4.95	10.75	53261-0471	4

MODEL NO. 53261-**71

REVISED
EC NO: J2008-0056
DRWN:KSAIT001 2007/07/31
CH'KD:THARUYAMA 2007/07/31
APPR:NUKITA 2007/08/10
DESCRIPTION
B
REV

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: ---
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

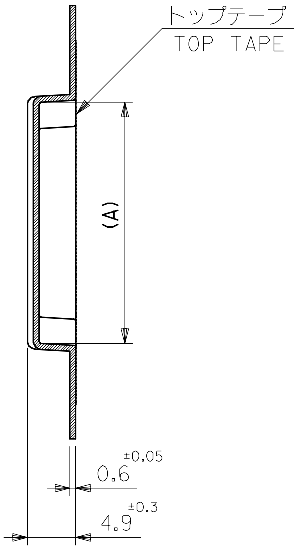
DRAWN BY: H.SHIMABUKUR DATE: '04/02/06
CHECKED BY: K.TOJO DATE: '04/02/06
APPROVED BY: M.SASAO DATE: '04/02/06

TITLE
1.25 W/B CONN WAFER ASSY
FOR SMT EMBSTP PKG

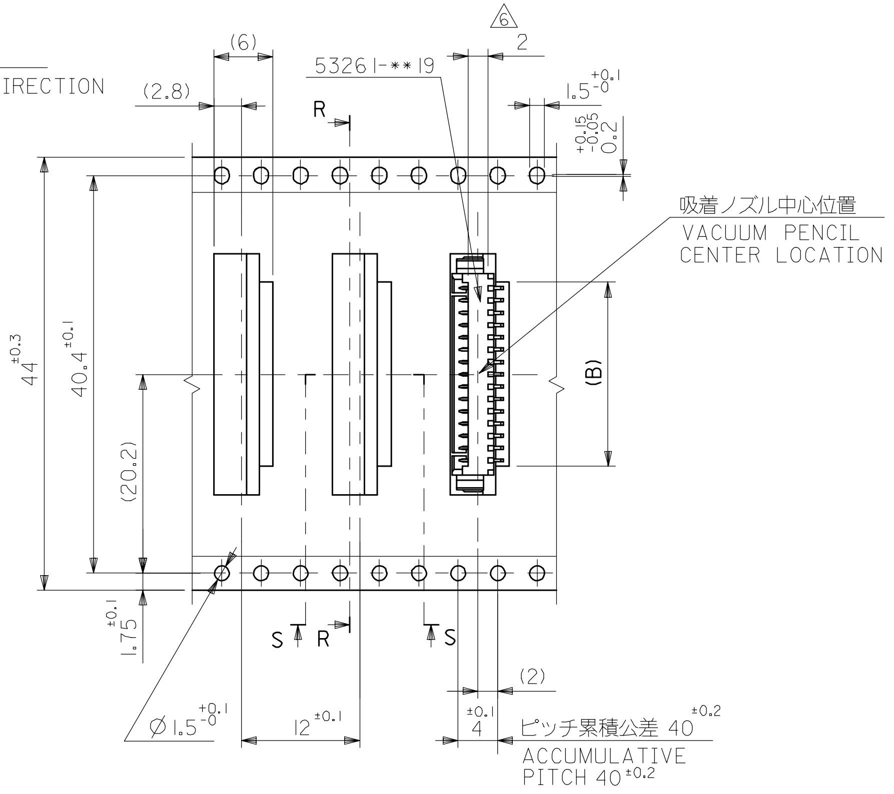
molex MOLEX INCORPORATED

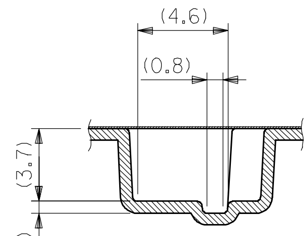
MATERIAL NO.: SEE CHART
DOCUMENT NO.: SD-53261-023
SHEET NO.: 2 OF 3
SIZE A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



SECT:R-R





SECT:S-S

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	B	A	MATERIAL. NO.	極数 CKT.
44	49.4	45.4	18.7	24.5	53261-1571	15
			17.45	23.25	53261-1471	14

MODEL NO. 53261-**71

REV	DESCRIPTION
B	REVISED EC NO: J2008-0056 DRWN:KSAIT001 2007/07/31 CH'KD:THARUYAMA 2007/07/31 APPR:NUKITA 2007/08/10

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY H.SHIMABUKUR	DATE '04/02/06
CHECKED BY K.TOJO	DATE '04/02/06
APPROVED BY M.SASAO	DATE '04/02/06

TITLE
1.25 W/B CONN WAFER ASSY
FOR SMT EMBSTP PKG

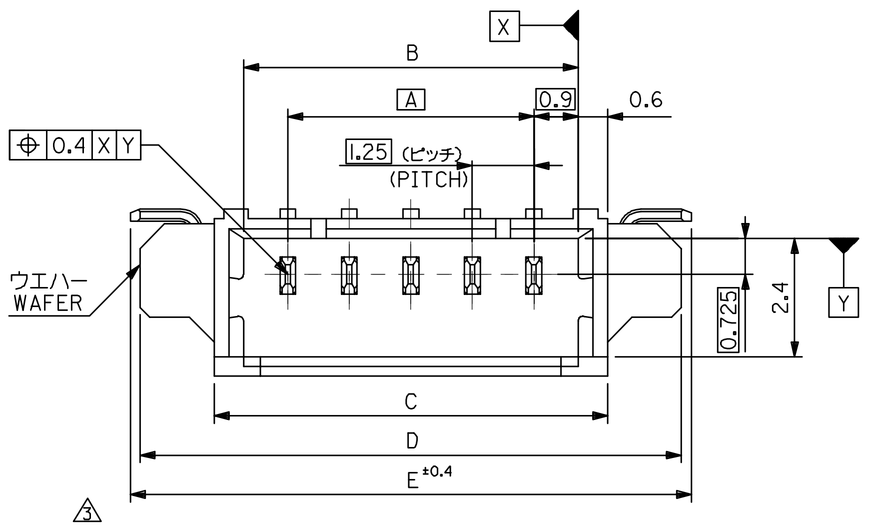
molex MOLEX INCORPORATED

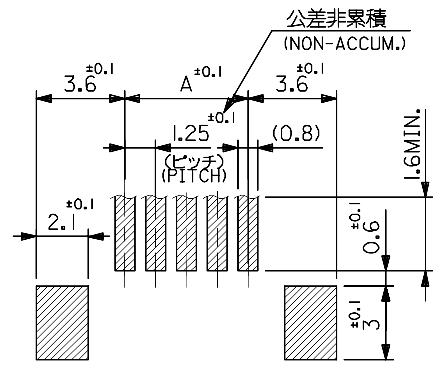
MATERIAL NO.
SEE CHART

DOCUMENT NO.
SD-53261-023

SHEET NO.
3 OF 3

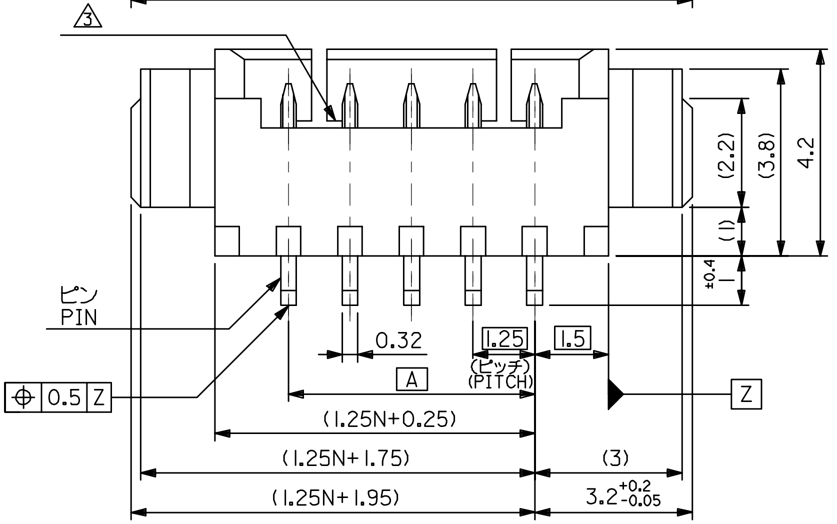
SIZE
A3

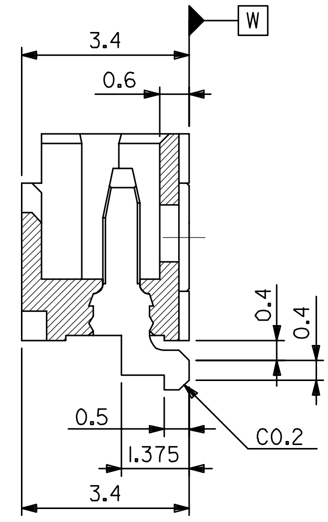




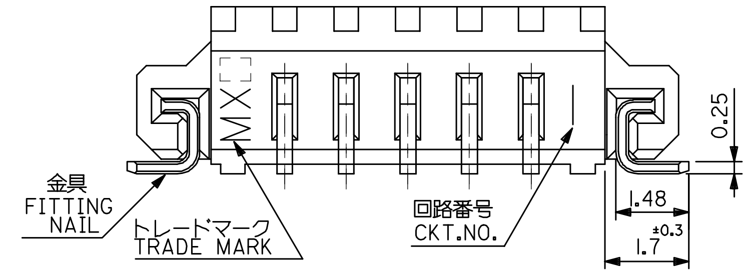
参考基板レイアウト
RECOMMENDED P.C.BOARD PATTERN DIM.(REF.)

(SCALE 5:1)





[断面図]
[CROSS SECTION]



注記 NOTES

1. 嵌合相手： 51021 シリーズ
MATES WITH: 51021 SERIES

2. 材質 MATERIAL
ウエハー ：NYLON46, UL94V-0
ピン ：リン青銅
PIN ：PHOS-BRO
：錫メッキ 1．0マイクロメートル以上
：TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
：ニッケル下地 1．0マイクロメートル以上
：NICKEL(UNDER PLATING)1.0 MICROMETER MINIMUM
金具 ：リン青銅
FITTING NAIL ：PHOS-BRO
：錫メッキ 1．0マイクロメートル以上
：TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
：ニッケル下地 1．0マイクロメートル以上
：NICKEL(UNDER PLATING)1.0 MICROMETER MINIMUM

3 ロック窓は2、3極は1箇所、4極以上は2箇所とする。
LOCKING WINDOW :
ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKT. AND
TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.

4. ソルダーテール部のズレ量及び金具（補強板）のズレ量は基準面 W に対し、上方向 0.05 MAX.、下方向に0.1 MAX. とする。 W
OFFSET BETWEEN BASIS PLANE TO SOLDER TAIL BOTTOM AND FITTING NAIL BOTTOM :
UPPER SIDE : 0.05MAX.
LOWER SIDE : 0.1MAX.

5. 本製品は 53261－＊＊10 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53261-**10

MODEL NO.	E	D	C	B	A	MATERIAL. NO.	極数 CKT.
	26.4	26	23	21.8	20	53261-1719	17
	23.9	23.5	20.5	19.3	17.5	-1519	15
	22.65	22.25	19.25	18.05	16.25	-1419	14
	21.4	21	18	16.8	15	-1319	13
	20.15	19.75	16.75	15.55	13.75	-1219	12
	18.9	18.5	15.5	14.3	12.5	-1119	11
	17.65	17.25	14.25	13.05	11.25	-1019	10
	16.4	16	13	11.8	10	-0919	9
	15.15	14.75	11.75	10.55	8.75	-0819	8
	13.9	13.5	10.5	9.3	7.5	-0719	7
	12.65	12.25	9.25	8.05	6.25	-0619	6
	11.4	11	8	6.8	5	-0519	5
	10.15	9.75	6.75	5.55	3.75	-0419	4
	8.9	8.5	5.5	4.3	2.5	-0319	3
53261-**19	7.65	7.25	4.25	3.05	1.25	53261-0219	2

REV	DESCRIPTION
E	REVISED EC NO: J2005-3130 DRWN:NAIDA 2005/04/19 CH'KD:KTOYODA 2005/04/21 APPR:NUKITA 2005/04/25

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3 °	

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: 10:1
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: HSHIMABU DATE: 04/02/06
CHECKED BY: KTOJO DATE: 04/02/06
APPROVED BY: MSASAO DATE: 04/02/06

TITLE
1.25 WIRE TO BOARD
WAFER ASS FOR SMT
-LEAD FREE-

molex MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE DRAWING
DOCUMENT NO.: SD-53261-024
SHEET NO.: 1 OF 1
SIZE: A3